

**OMNIMATE Housing - Serie CH20M
CH20M FE 12-67 1.5SN RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Contatto FE****Affidabilità funzionale: sia completamente integrato o semplicemente montato**

Il collegamento opzionale "CH20M FE" protegge in modo ottimale il vostro sistema con un contatto per guida di supporto per la messa a terra funzionale.

- Il contatto di terra funzionale preassemblato nella custodia da 6 mm consente un collegamento permanente ed affidabile degli schermi per i circuiti elettronici (ad es. "CH20M6 BP 4P-4P FE BK", 1 164650000) alla guida di supporto
- Un contatto di messa a terra funzionale, che può essere elaborato in maniera completamente automatica utilizzando il metodo reflow abbinato ai connettori maschi e un contatto bus opzionale, è disponibile per custodie da 12,5 a 67,5 mm. La posizione del circuito stampato nella custodia specifica la lunghezza codolo di 1,5 mm / 3,2 mm

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH20M FE 12-67 1.5SN RL
Nr.Cat.	1189370000
Versione	Custodie per componenti elettronici, Accessori, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli: 1, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, Tape
GTIN (EAN)	4032248972715
CPZ	750 Pezzo
Parametri prodotto	UL:
Imballaggio	Tape

**OMNIMATE Housing - Serie CH20M
CH20M FE 12-67 1.5SN RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 0,482 g

Dati del materiale

Superficie dei contatti stagnato

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002637	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-18-92-90
eClass 7.1	27-18-92-90	eClass 8.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-27-90	eClass 9.1	27-18-27-90

Note

Note

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

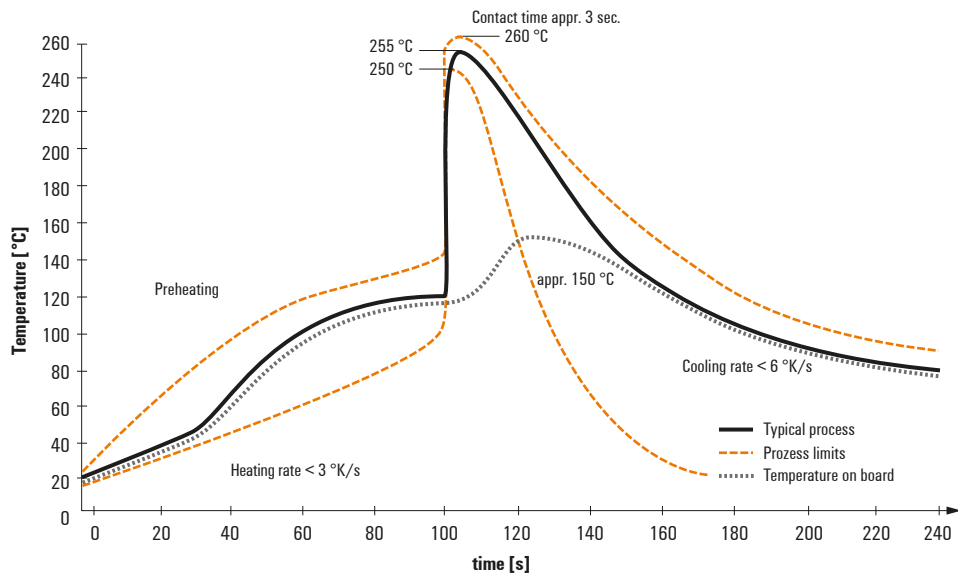
Brochure/Catalogo [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Dati ingegneristici [STEP](#)

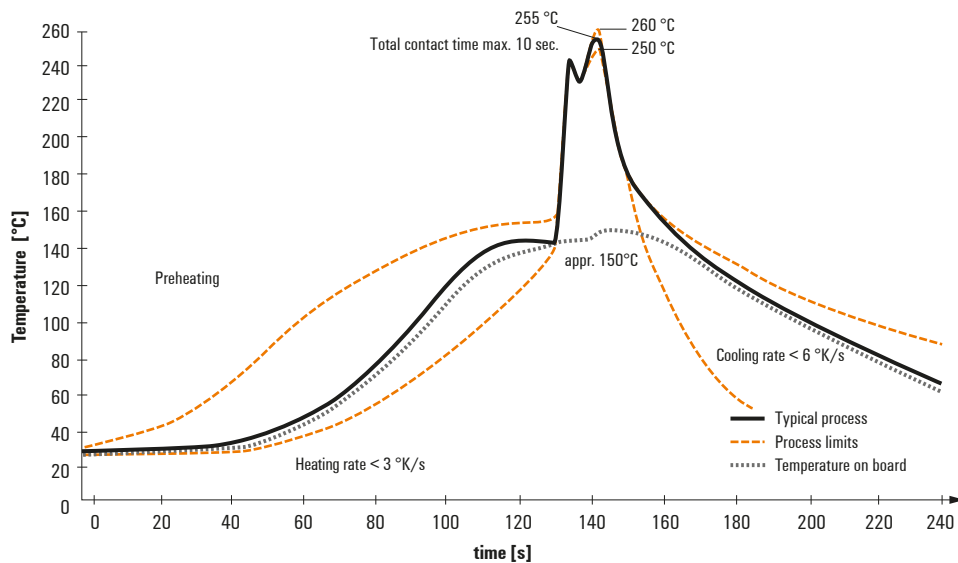
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

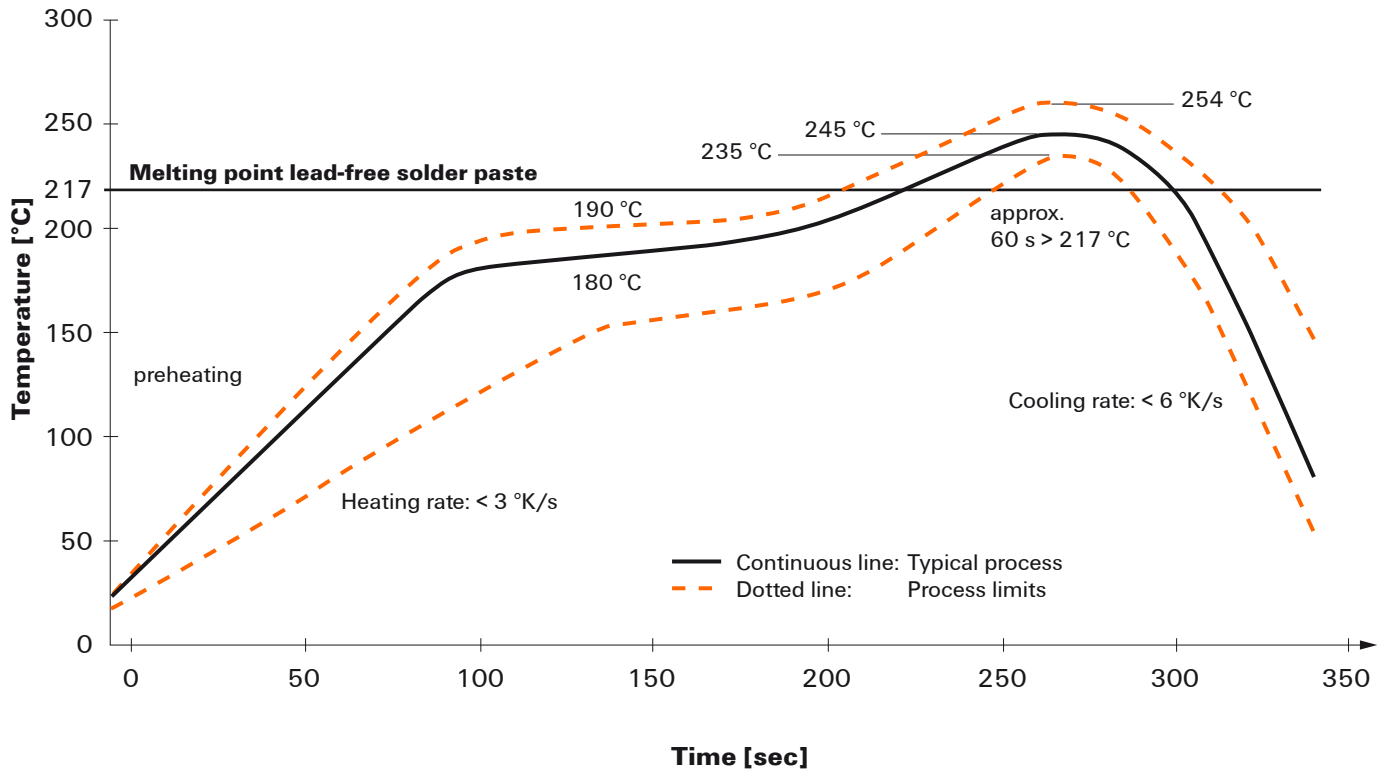
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260 °C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.